

eSUN主要耗材快速打印机打印参数												
材料	打印机品牌	型号	打印温度	层高, 线宽	打印速度	加速度	回抽量	挤出	冷却	最大体积速度	其他参数	其他注意事项
PLA+	拓竹 Bambu Lab	PIP	喷嘴温度: 220°C 底板温度: 60°C (PET板)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 250mm/s 外墙: 300mm/s 内墙: 300mm/s 稀疏填充: 300mm/s 内部实心填充: 250mm/s 顶部: 200mm/s 悬垂速度: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外墙: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	流量比例: 0.98	风扇: 开 软件默认参数	22mm ³ /s	默认或根据需求调整	同一个模型打印速度不要相差太大, 速度相差太大, 打印光泽度不一样。
		X1	喷嘴温度: 220°C 底板温度: 35°C (低温板, 涂胶)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外墙: 250mm/s 内墙: 300mm/s 稀疏填充: 300mm/s 内部实心填充: 250mm/s 顶部: 200mm/s 悬垂速度: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外墙: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	流量比例: 0.98	风扇: 开 软件默认参数	22mm ³ /s	默认或根据需求调整	同一个模型打印速度不要相差太大, 速度相差太大, 打印光泽度不一样。
	创想 Creality	K1	喷嘴温度: 220°C 底板温度: 60°C	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	填充速度: 300mm/s 外墙速度: 200mm/s 内墙速度: 300mm/s 顶部/底部速度: 200mm/s 空驶速度: 500mm/s 起始层速度: 50mm/s 裙摆速度: 50mm/s	填充加速度: 12000 外墙加速度: 5000 内墙加速度: 5000 顶部加速度: 5000 空驶加速度: 12000 起始层加速度: 500 裙摆加速度: 500	回抽长度: 0.8mm 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 其他参数默认	外壁流量: 90% 内壁流量: 100% 顶部流量: 100% 填充流量: 100% 起始层流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100% 辅助风扇速度: 30%	默认或根据需求调整		打印时不封箱
		K1 MAX	喷嘴温度: 220°C 底板温度: 60°C	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	填充速度: 300mm/s 外墙速度: 200mm/s 内墙速度: 300mm/s 顶部/底部速度: 200mm/s 空驶速度: 500mm/s 起始层速度: 50mm/s 裙摆速度: 50mm/s	填充加速度: 12000 外墙加速度: 5000 内墙加速度: 5000 顶部加速度: 5000 空驶加速度: 12000 起始层加速度: 500 裙摆加速度: 500	回抽长度: 0.8mm 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 其他参数默认	外壁流量: 90% 内壁流量: 100% 顶部流量: 100% 填充流量: 100% 起始层流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100% 辅助风扇速度: 30%	默认或根据需求调整		打印时不封箱
		Ender-3	喷嘴温度: 215°C 底板温度: 60°C (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 0.4mm 起始层线宽: 120%	打印速度: 50mm/s 填充速度: 50mm/s 速度(壁): 30mm/s 速度(内壁): 25mm/s 速度(顶部): 100mm/s 起始层速度: 20mm/s Skirt速度: 20mm/s 较慢层数量: 2	关闭	层变化回抽: 开 回抽距离: 6mm 回抽速度: 40mm/s 表填速度: 40mm/s	流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/		默认或根据需求调整
	复志 Raise3D	Pro3 Plus (高速)	喷嘴温度: 225°C 底板温度: 60°C	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 0.4mm 起始层线宽: 130%	默认打印速度: 200mm/s 内墙打印速度: 300mm/s 外墙打印速度: 200mm/s 底层打印速度: 50mm/s 填充速度: 275mm/s 实心填充速度: 100mm/s Z轴运动速度: 200mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 300mm/s 薄壁结构速度: 150mm/s 填充空腔速度: 150mm/s 桥接速度: 50mm/s 悬垂结构速度: 50mm/s	软件默认参数	软件默认参数	材料流量: 95%	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
	Prusa	MK3S+	喷嘴温度: 215°C 底板温度: 60°C (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 50mm/s 小边界: 25mm/s 外围轮廓: 25mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 80mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s 空驶速度: 100mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撞高Z: 0.2 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量: 50%	挤出倍数: 1	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
	Voron	R2	喷嘴温度: 215°C 底板温度: 60°C (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 150mm/s 小边界: 80mm/s 外围轮廓: 80mm/s 填充: 150mm/s 实心填充: 150mm/s 顶部实心填充: 80mm/s 支撑材料: 150mm/s 桥接处: 40mm/s 间隙填充: 40mm/s 空驶速度: 200mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撞高Z: 0.2 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量: 0%	挤出倍数: 1	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
	安克	M5	喷嘴温度: 215°C 底板温度: 60°C	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	空驶速度: 250mm/s 打印速度: 250mm/s 填充速度: 250mm/s 外墙速度: 150mm/s 内墙速度: 150mm/s 起始层速度: 50mm/s Skirt速度: 50mm/s	软件默认参数	软件默认参数	挤出量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/	默认或根据需求调整	/
	拓竹	PIP	喷嘴温度: 220°C 底板温度: 65°C (PET板)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外墙: 250mm/s 内墙: 300mm/s 稀疏填充: 300mm/s 内部实心填充: 250mm/s 顶部: 200mm/s 悬垂速度: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外墙: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	流量比例: 0.98	风扇: 开 软件默认参数	22mm ³ /s	默认或根据需求调整	同一个模型打印速度不要相差太大, 速度相差太大, 打印光泽度不一样。

ePLA-HS	Bambu Lab	X1	喷嘴温度:220℃ 底板温度:35℃ (低温板,涂胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:软件默认参数	首层速度:50mm/s 首层填充:50mm/s 外墙:250mm/s 内墙:300mm/s 稀疏填充:300mm/s 内部实心填充:250mm/s 顶部:200mm/s 悬垂降速:开 悬垂速度:默认 桥接:50mm/s 填充:250mm/s 空驶速度:300mm/s	首层:500 外墙:5000 顶部:2000 普通打印:10000	软件默认参数	流量比例:0.98	风扇:开 软件默认参数	22mm³/s	默认或根据需求调整	同一个模型打印速度不要相差太大,速度相差太大,打印光滑度不一样。
	创想 Creality	K1	喷嘴温度:220℃ 底板温度:60℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:软件默认参数	填充速度:300mm/s 外壁速度:200mm/s 内壁速度:300mm/s 顶部/底部速度:200mm/s 空驶速度:500mm/s 起始层速度:50mm/s 裙摆速度:50mm/s	填充加速度:12000 外壁加速度:5000 内壁加速度:5000 顶部加速度:5000 空驶加速度:12000 起始层加速度:500 裙摆加速度:500	回抽长度:0.8mm 回抽速度:40mm/s 层变化回抽:开 其他参数默认	外壁流量:90% 内壁流量:100% 顶部流量:100% 填充流量:100% 起始层流量:100%	风扇:开 风扇速度:100% 辅助风扇速度:30%		默认或根据需求调整	打印时不封箱
		K1 MAX	喷嘴温度:220℃ 底板温度:60℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:软件默认参数	填充速度:300mm/s 外壁速度:200mm/s 内壁速度:300mm/s 顶部/底部速度:200mm/s 空驶速度:500mm/s 起始层速度:50mm/s 裙摆速度:50mm/s	填充加速度:12000 外壁加速度:5000 内壁加速度:5000 顶部加速度:5000 空驶加速度:12000 起始层加速度:500 裙摆加速度:500	回抽长度:0.8mm 回抽速度:40mm/s 层变化回抽:开 其他参数默认	外壁流量:90% 内壁流量:100% 顶部流量:100% 填充流量:100% 起始层流量:100%	风扇:开 风扇速度:100% 辅助风扇速度:30%		默认或根据需求调整	打印时不封箱
		Ender-3	喷嘴温度:215℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:软件默认参数	打印速度:50mm/s 填充速度:50mm/s 速度(壁):30mm/s 速度(外壁):25mm/s 速度(内壁):30mm/s 速度(顶部):25mm/s 空驶速度:100mm/s 起始层速度:20mm/s Skirt速度:20mm/s 软慢层数量:2	关闭	层变化回抽:开 回抽距离:6mm 回抽速度:40mm/s 装填速度:40mm/s	挤出量:100%	风扇:开 风扇速度:100%		默认或根据需求调整	
	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:225℃ 底板温度:60℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:0.4mm 始层线宽:130%	默认打印速度:200mm/s 内壁打印速度:300mm/s 外壁打印速度:200mm/s 底层打印速度:50mm/s 填充速度:275mm/s 实心填充速度:100mm/s X/Y轴运动速度:200mm/s Z轴运动速度:15mm/s 支撑打印速度:300mm/s 薄壁结构速度:150mm/s 填充空隙速度:150mm/s 桥接速度:50mm/s 悬垂结构速度:50mm/s	软件默认参数	软件默认速度	材料流量:95%	风扇:开 软件默认参数		默认或根据需求调整	
	Prusa	MK3S+	喷嘴温度:215℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度:软件默认参数	轮廓:50mm/s 小边界:25mm/s 外圆轮廓:25mm/s 填充:80mm/s 实心填充:40mm/s 顶部实心填充:40mm/s 支撑材料:50mm/s 桥接处:25mm/s 间隙填充:40mm/s	软件默认参数	回抽长度:2mm 撞高Z:0.2 回抽速度:40mm/s 层变化回抽:开 回抽时擦拭:开 擦拭前的回缩量:50%	挤出倍数:1	风扇:开 软件默认参数		默认或根据需求调整	
	Voron	R2	喷嘴温度:215℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度:软件默认参数	轮廓:150mm/s 小边界:80mm/s 外圆轮廓:80mm/s 填充:150mm/s 实心填充:150mm/s 顶部实心填充:80mm/s 支撑材料:150mm/s 桥接处:40mm/s 间隙填充:40mm/s 空驶速度:200mm/s	软件默认参数	回抽长度:2mm 撞高Z:0.2 回抽速度:40mm/s 层变化回抽:开 回抽时擦拭:开 擦拭前的回缩量:0%	挤出倍数:1	风扇:开 软件默认参数		默认或根据需求调整	
	安克	M5	喷嘴温度:215℃ 底板温度:60℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:默认参数	空驶速度:250mm/s 打印速度:250mm/s 填充速度:250mm/s 外壁速度:100mm/s 内壁速度:150mm/s 起始层速度:50mm/s Skirt速度:50mm/s	软件默认参数	软件默认参数	挤出量:100%	风扇:开 风扇速度:100%		默认或根据需求调整	
	拓竹 Bambu Lab	PIP	喷嘴温度:220℃ 底板温度:60℃ (PET板)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:默认参数	首层速度:50mm/s 首层填充:50mm/s 外墙:200mm/s 内墙:250mm/s 稀疏填充:300mm/s 内部实心填充:250mm/s 顶部:200mm/s 悬垂降速:开 悬垂速度:默认 桥接:50mm/s 填充:250mm/s 空驶速度:300mm/s	首层:500 外墙:5000 顶部:2000 普通打印:10000	软件默认参数	流量比例:0.98	风扇:开 软件默认参数	22mm³/s	默认或根据需求调整	同一个模型打印速度不要相差太大,速度相差太大,打印光滑度不一样。
		X1	喷嘴温度:220℃ 底板温度:35℃ (低温板,需配固体胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:默认参数	首层速度:50mm/s 首层填充:50mm/s 外墙:200mm/s 内墙:250mm/s 稀疏填充:300mm/s 内部实心填充:250mm/s 顶部:200mm/s 悬垂降速:开 悬垂速度:默认 桥接:50mm/s 填充:250mm/s 空驶速度:300mm/s	首层:500 外墙:5000 顶部:2000 普通打印:10000	软件默认参数	流量比例:0.98	风扇:开 软件默认参数	22mm³/s	默认或根据需求调整	同一个模型打印速度不要相差太大,速度相差太大,打印光滑度不一样。

ePLA-Lite	创想 Creality	K1	喷嘴温度:220℃ 底板温度:60℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	填充速度: 300mm/s 外壁速度: 150mm/s 内壁速度: 300mm/s 顶部/底部速度: 200mm/s 空驶速度: 500mm/s 起始层速度: 50mm/s 裙摆速度: 50mm/s	填充加速度: 12000 外壁加速度: 5000 内壁加速度: 5000 顶部加速度: 5000 空驶加速度: 12000 起始层加速度: 500 裙摆加速度: 500	回抽长度: 0.8mm 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 其他参数默认	外壁流量: 90% 内壁流量: 100% 顶部流量: 100% 填充流量: 100% 起始层流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100% 辅助风扇速度: 30%	默认或根据需求调整	打印时不封箱
		K1 MAX	喷嘴温度:220℃ 底板温度:60℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	填充速度: 300mm/s 外壁速度: 150mm/s 内壁速度: 300mm/s 顶部/底部速度: 200mm/s 空驶速度: 500mm/s 起始层速度: 50mm/s 裙摆速度: 50mm/s	填充加速度: 12000 外壁加速度: 5000 内壁加速度: 5000 顶部加速度: 5000 空驶加速度: 12000 起始层加速度: 500 裙摆加速度: 500	回抽长度: 0.8mm 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 其他参数默认	外壁流量: 90% 内壁流量: 100% 顶部流量: 100% 填充流量: 100% 起始层流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100% 辅助风扇速度: 30%	默认或根据需求调整	打印时不封箱
		Ender-3	喷嘴温度:215℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	打印速度: 50mm/s 填充速度: 50mm/s 速度(壁): 30mm/s 速度(内壁): 30mm/s 速度(顶部): 25mm/s 空驶速度: 100mm/s 起始层速度: 20mm/s Skirt速度: 20mm/s 较慢层数量: 2	关闭	层变化回抽: 开 回抽距离: 6mm 回抽速度: 40mm/s 表填速度: 40mm/s	流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	默认或根据需求调整	/
	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:225℃ 底板温度:60℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 0.4mm 起始层线宽: 130%	默认打印速度: 150mm/s 内壁打印速度: 150mm/s 外壁打印速度: 100mm/s 底层打印速度: 50mm/s 填充速度: 100mm/s 实心填充速度: 100mm/s Z轴运动速度: 200mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 200mm/s 薄壁结构速度: 150mm/s 填充空隙速度: 150mm/s 桥结构速度: 50mm/s 悬垂结构速度: 50mm/s	软件默认参数	软件默认速度	材料流量: 95%	风扇: 开 软件默认参数	默认或根据需求调整	/
	Prusa	MK3S+	喷嘴温度:215℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 50mm/s 小边界: 25mm/s 外围轮廓: 25mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 80mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撞高Z: 0.2 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量: 50%	挤出倍数: 1	风扇: 开 软件默认参数	默认或根据需求调整	/
	Voron	R2	喷嘴温度:215℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 150mm/s 小边界: 80mm/s 外围轮廓: 80mm/s 填充: 150mm/s 实心填充: 80mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 150mm/s 桥接处: 40mm/s 间隙填充: 40mm/s 空驶速度: 200mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撞高Z: 0.2 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量: 0%	挤出倍数: 1	风扇: 开 软件默认参数	默认或根据需求调整	/
	安克	M5	喷嘴温度:215℃ 底板温度:60℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	空驶速度: 250mm/s 打印速度: 150mm/s 填充速度: 150mm/s 外壁速度: 50mm/s 内壁速度: 50mm/s 起始层速度: 50mm/s Skirt速度: 50mm/s	软件默认参数	软件默认参数	挤出量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	默认或根据需求调整	/
拓竹 Bambu Lab	PIP	喷嘴温度:220℃ 底板温度:60℃ (PET板)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外墙: 150mm/s 内墙: 250mm/s 稀疏填充: 250mm/s 内部实心填充: 250mm/s 顶面: 200mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填缝: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外墙: 5000 顶面: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	流量比例: 0.98	风扇: 开 软件默认参数	22mm ³ /s	默认或根据需求调整	1. 同一个模型打印速度不要相差太大, 速度相差太大, 打印光泽度不一样。
	X1	喷嘴温度:220℃ 底板温度:35℃ (低温板, 需配固体胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外墙: 150mm/s 内墙: 250mm/s 稀疏填充: 250mm/s 内部实心填充: 250mm/s 顶面: 200mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填缝: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外墙: 5000 顶面: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	流量比例: 0.98	风扇: 开 软件默认参数	22mm ³ /s	默认或根据需求调整	同一个模型打印速度不要相差太大, 速度相差太大, 打印光泽度不一样。
	K1	喷嘴温度:220℃ 底板温度:60℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	填充速度: 300mm/s 外壁速度: 100mm/s 内壁速度: 150mm/s 顶部/底部速度: 200mm/s 空驶速度: 500mm/s 起始层速度: 50mm/s 裙摆速度: 50mm/s	填充加速度: 12000 外壁加速度: 5000 内壁加速度: 5000 顶部加速度: 5000 空驶加速度: 12000 起始层加速度: 500 裙摆加速度: 500	回抽长度: 0.8mm 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 其他参数默认	外壁流量: 100% 内壁流量: 100% 顶部流量: 100% 填充流量: 100% 起始层流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100% 辅助风扇速度: 30%	默认或根据需求调整	打印时不封箱	

ePLA-Matte	创想 Creality	K1 MAX	喷嘴温度:220℃ 底板温度:60℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	填充速度: 300mm/s 外壁速度: 100mm/s 内壁速度: 150mm/s 顶部/底部速度: 200mm/s 空驶速度: 500mm/s 起始层速度: 50mm/s 裙摆速度: 50mm/s	填充加速度: 12000 外壁加速度: 5000 内壁加速度: 5000 顶部加速度: 5000 空驶加速度: 12000 起始层加速度: 500 裙摆加速度: 500	回抽长度: 0.8mm 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 其他参数默认	外壁流量: 100% 内壁流量: 100% 顶部流量: 100% 填充流量: 100% 起始层流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100% 辅助风扇速度: 30%	默认或根据需求调整	打印时不封箱
		Ender-3	喷嘴温度:220℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	打印速度: 50mm/s 填充速度: 50mm/s 速度(壁): 30mm/s 速度(外壁): 25mm/s 速度(内壁): 30mm/s 速度(顶部): 25mm/s 空驶速度: 100mm/s 起始层速度: 20mm/s Skirt速度: 20mm/s 较慢层数量: 2	关闭	层变化回抽: 开 回抽距离: 6mm 回抽速度: 60mm/s 装填速度: 60mm/s	流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	默认或根据需求调整	/
	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:225℃ 底板温度:60℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 起 线宽: 0.4mm 始层线宽: 130%	默认打印速度: 60mm/s 内壁打印速度: 30mm/s 外壁打印速度: 20mm/s 底层打印速度: 20mm/s 填充速度: 60mm/s 空心填充速度: 60mm/s X/Y轴运动速度: 100mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 60mm/s 薄壁结构速度: 40mm/s 填充空隙速度: 40mm/s 桥结构速度: 30mm/s 悬垂结构速度: 30mm/s	软件默认参数	软件默认速度	材料流量: 95%	风扇: 开 软件默认参数	默认或根据需求调整	/
	Prusa	MK3S+	喷嘴温度:220℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 50mm/s 小边界: 25mm/s 外轮廓: 25mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 80mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撞高Z: 0.2 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量: 50%	挤出倍数: 1	风扇: 开 软件默认参数	默认或根据需求调整	/
	Voron	R2	喷嘴温度:225℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 100mm/s 小边界: 50mm/s 外轮廓: 50mm/s 填充: 100mm/s 实心填充: 100mm/s 顶部实心填充: 80mm/s 支撑材料: 150mm/s 桥接处: 40mm/s 间隙填充: 40mm/s 空驶速度: 200mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撞高Z: 0.2 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量: 0%	挤出倍数: 1.02	风扇: 开 软件默认参数	默认或根据需求调整	/
	安克	M5	喷嘴温度:225℃ 底板温度:60℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	空驶速度: 250mm/s 打印速度: 120mm/s 填充速度: 120mm/s 外壁速度: 50mm/s 内壁速度: 100mm/s 起始层速度: 50mm/s Skirt速度: 50mm/s	软件默认参数	软件默认参数	流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	默认或根据需求调整	/
拓竹 Bambu Lab	PIP	喷嘴温度:205℃ 底板温度:60℃ (PET板)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外端: 200mm/s 内端: 250mm/s 稀疏填充: 250mm/s 内部实心填充: 250mm/s 顶面: 200mm/s 悬垂速度: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外端: 5000 顶面: 2000 普通打印: 10000	回抽长度: 1.5mm 回抽速度: 30mm/s	流量比例: 0.98	风扇: 开 软件默认参数	22mm/s	默认或根据需求调整	同一个模型打印速度不要相差太大, 速度相差太大, 打印光泽度不一样。
	X1	喷嘴温度:205℃ 底板温度:35℃ (低温板, 涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外端: 200mm/s 内端: 250mm/s 稀疏填充: 250mm/s 内部实心填充: 250mm/s 顶面: 200mm/s 悬垂速度: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外端: 5000 顶面: 2000 普通打印: 10000	回抽长度: 1.5mm 回抽速度: 30mm/s	流量比例: 0.98	风扇: 开 软件默认参数	22mm/s	默认或根据需求调整	同一个模型打印速度不要相差太大, 速度相差太大, 打印光泽度不一样。
	K1	喷嘴温度:205℃ 底板温度:60℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	填充速度: 300mm/s 外壁速度: 150mm/s 内壁速度: 200mm/s 顶部/底部速度: 200mm/s 空驶速度: 500mm/s 起始层速度: 50mm/s 裙摆速度: 50mm/s	填充加速度: 12000 外壁加速度: 5000 内壁加速度: 5000 顶部加速度: 5000 空驶加速度: 12000 起始层加速度: 500 裙摆加速度: 500	回抽长度: 0.8mm 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 其他参数默认	外壁流量: 95% 内壁流量: 100% 顶部流量: 100% 填充流量: 100% 起始层流量: 100%	风扇: 开 软件默认参数	默认或根据需求调整	打印时不封箱	
创想 Creality	K1 MAX	喷嘴温度:205℃ 底板温度:60℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	填充速度: 300mm/s 外壁速度: 150mm/s 内壁速度: 200mm/s 顶部/底部速度: 200mm/s 空驶速度: 500mm/s 起始层速度: 50mm/s 裙摆速度: 50mm/s	填充加速度: 12000 外壁加速度: 5000 内壁加速度: 5000 顶部加速度: 5000 空驶加速度: 12000 起始层加速度: 500 裙摆加速度: 500	回抽长度: 0.8mm 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 其他参数默认	外壁流量: 95% 内壁流量: 100% 顶部流量: 100% 填充流量: 100% 起始层流量: 100%	风扇: 开 软件默认参数	默认或根据需求调整	打印时不封箱	

ePLA-S11k		Ender-3	喷嘴温度:200℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:软件默认参数	打印速度: 50mm/s 填充速度: 50mm/s 速度(壁): 30mm/s 速度(外壁): 25mm/s 速度(内壁): 30mm/s 速度(顶部): 25mm/s 空驶速度: 100mm/s 起始层速度: 20mm/s Skirt速度: 20mm/s 较慢层数量: 2	关闭	层变化回抽: 开 回抽距离: 6mm 回抽速度: 60mm/s 装填速度: 60mm/s	流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/	默认或根据需求调整	/	
	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:205℃ 底板温度:60℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 起 始层线宽:130%	默认打印速度: 60mm/s 内壁打印速度: 30mm/s 外壁打印速度: 20mm/s 底层打印速度: 20mm/s 填充速度: 60mm/s 实心填充速度: 60mm/s X/Y轴运动速度: 100mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 60mm/s 薄壁结构速度: 40mm/s 填充空隙速度: 40mm/s 桥接速度: 30mm/s 悬垂结构速度: 30mm/s	软件默认参数	软件默认速度	材料流量: 95%	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/	
	Prusa	MK3S+	喷嘴温度:200℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度:软件默认参数	轮廓: 50mm/s 小边界: 25mm/s 外圈轮廓: 25mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 80mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s	软件默认参数		回抽长度: 2mm 撞高Z: 0.2 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:50%	挤出倍数: 1	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
	Voron	R2	喷嘴温度:205℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度:软件默认参数	轮廓: 120mm/s 小边界: 70mm/s 外圈轮廓: 70mm/s 填充: 150mm/s 实心填充: 150mm/s 顶部实心填充: 70mm/s 支撑材料: 150mm/s 桥接处: 40mm/s 间隙填充: 40mm/s 空驶速度: 200mm/s	软件默认参数		回抽长度: 2mm 撞高Z: 0.2 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:0%	挤出倍数: 1	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
	安克	M5	喷嘴温度:210℃ 底板温度:60℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:默认参数	空驶速度: 250mm/s 打印速度: 200mm/s 填充速度: 200mm/s 外壁速度: 100mm/s 内壁速度: 100mm/s 起始层速度: 50mm/s Skirt速度: 50mm/s	软件默认参数	软件默认参数	流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/	默认或根据需求调整	/	
PETG	拓竹 Bambu Lab	PIP	喷嘴温度:260℃ 底板温度:80℃ (PEI板)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外端: 200mm/s 内端: 200mm/s 稀疏填充: 200mm/s 内部实心填充: 200mm/s 顶面: 150mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 250mm/s 空驶速度: 500mm/s	首层: 500 外端: 5000 顶面: 2000 普通打印: 10000	回抽长度: 2mm 撞高Z: 0 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:70%	流量比例: 0.98	风扇: 开 软件默认参数	15mm ³ /s	默认或根据需求调整	同一个模型打印速度不要相差太大, 速度相差太大, 打印光泽度不一样。	
		X1	喷嘴温度:260℃ 底板温度:80℃ (低温板, 涂胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外端: 200mm/s 内端: 200mm/s 稀疏填充: 200mm/s 内部实心填充: 200mm/s 顶面: 150mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 250mm/s 空驶速度: 500mm/s	首层: 500 外端: 5000 顶面: 2000 普通打印: 10000	回抽长度: 2mm 撞高Z: 0 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:70%	流量比例: 0.98	风扇: 开 软件默认参数	15mm ³ /s	默认或根据需求调整	同一个模型打印速度不要相差太大, 速度相差太大, 打印光泽度不一样。	
	创想 Creality	Ender-3	喷嘴温度:235℃ 底板温度:90℃ (涂胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:软件默认参数	打印速度: 50mm/s 填充速度: 50mm/s 速度(壁): 30mm/s 速度(外壁): 25mm/s 速度(内壁): 30mm/s 速度(顶部): 25mm/s 空驶速度: 100mm/s 起始层速度: 20mm/s Skirt速度: 20mm/s 较慢层数量: 2	关闭	层变化回抽: 开 回抽距离: 6mm 回抽速度: 60mm/s 装填速度: 60mm/s	流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/	默认或根据需求调整	/	
	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:240℃ 底板温度:90℃ (涂胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 起 始层线宽:130%	默认打印速度: 60mm/s 内壁打印速度: 30mm/s 外壁打印速度: 20mm/s 底层打印速度: 20mm/s 填充速度: 60mm/s 实心填充速度: 60mm/s X/Y轴运动速度: 100mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 60mm/s 薄壁结构速度: 40mm/s 填充空隙速度: 40mm/s 桥接速度: 30mm/s 悬垂结构速度: 30mm/s	软件默认参数	软件默认速度	材料流量: 95%	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/	
	Prusa	MK3S+	喷嘴温度:240℃ 底板温度:90℃ (涂胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度:软件默认参数	轮廓: 40mm/s 小边界: 30mm/s 外圈轮廓: 30mm/s 填充: 50mm/s 实心填充: 50mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 20mm/s 间隙填充: 20mm/s 空驶速度: 100mm/s	软件默认参数		回抽长度: 3mm 撞高Z: 关 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:50%	挤出倍数: 1	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/

	Voron	R2	喷嘴温度:240℃ 底板温度:90℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 100mm/s 小边界: 50mm/s 外围轮廓: 50mm/s 填充: 150mm/s 实心填充: 100mm/s 顶部实心填充: 50mm/s 支撑材料: 150mm/s 桥接处: 40mm/s 间隙填充: 40mm/s 空驶速度: 200mm/s	软件默认参数	回抽长度: 3mm 撤高低: 关 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:50%	挤出倍数: 1	风扇: 开 软件默认参数	默认或根据需求调整	/	
	安克	M5	喷嘴温度:240℃ 底板温度:90℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	空驶速度: 250mm/s 打印速度: 100mm/s 填充速度: 150mm/s 外壁速度: 50mm/s 内壁速度: 100mm/s 起始层速度: 50mm/s Skirt速度: 50mm/s	软件默认参数	软件默认参数	流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	默认或根据需求调整	/	
拓竹 Bambu Lab	PIP		喷嘴温度:250℃ 底板温度:100℃ (PEI板, 涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外端: 150mm/s 内端: 200mm/s 稀疏填充: 200mm/s 内部实心填充: 200mm/s 顶面: 150mm/s 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 200mm/s 空驶速度: 200mm/s	首层: 500 外端: 5000 顶面: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	流量比例: 0.98	风扇: 开 最小风扇速度: 10% 最大风扇速度: 30%	22mm ³ /s	默认或根据需求调整	1.需要封箱打印2.同一个模型打印速度不要相差太大,速度相差太大,打印光泽度不一样。
	X1		喷嘴温度:250℃ 底板温度:100℃ (工程, 涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外端: 150mm/s 内端: 200mm/s 稀疏填充: 200mm/s 内部实心填充: 200mm/s 顶面: 150mm/s 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 200mm/s 空驶速度: 200mm/s	首层: 500 外端: 5000 顶面: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	流量比例: 0.98	风扇: 开 最小风扇速度: 10% 最大风扇速度: 30%	22mm ³ /s	默认或根据需求调整	1.需要封箱打印2.同一个模型打印速度不要相差太大,速度相差太大,打印光泽度不一样。
	创想 Creality	Ender-3	喷嘴温度:240℃ 底板温度:100℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	打印速度: 50mm/s 填充速度: 50mm/s 速度(壁): 30mm/s 速度(外壁): 25mm/s 速度(内壁): 30mm/s 速度(顶部): 25mm/s 空驶速度: 100mm/s 起始层速度: 20mm/s Skirt速度: 20mm/s 较慢层数量: 2	关闭	层变化回抽: 开 回抽距离: 6mm 回抽速度: 40mm/s 装填速度: 40mm/s	流量: 100%	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	需要封箱打印
ABS	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:255℃ 底板温度:100℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 0.4mm 起始层线宽: 130%	默认打印速度: 60mm/s 内层打印速度: 30mm/s 外层打印速度: 20mm/s 填充速度: 60mm/s 空驶速度: 60mm/s X/Y轴运动速度: 100mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 60mm/s 薄壁结构速度: 40mm/s 填充空隙速度: 40mm/s 桥接结构速度: 30mm/s 桥垂结构速度: 30mm/s	软件默认参数	软件默认速度	材料流量: 98%	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	需要封箱打印
	Prusa	MK3S+	喷嘴温度:250℃ 底板温度:100℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 50mm/s 小边界: 25mm/s 外围轮廓: 25mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 80mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撤高低: 0.2 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:50%	挤出倍数: 1	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	需要封箱打印
	Voron	R2	喷嘴温度:255℃ 底板温度:100℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 80mm/s 小边界: 60mm/s 外围轮廓: 80mm/s 填充: 150mm/s 实心填充: 150mm/s 顶部实心填充: 80mm/s 支撑材料: 150mm/s 桥接处: 40mm/s 间隙填充: 40mm/s 空驶速度: 200mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撤高低: 0.2 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:0%	挤出倍数: 1	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	需要封箱打印
	安克	M5	喷嘴温度:250℃ 底板温度:100℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	空驶速度: 250mm/s 打印速度: 200mm/s 填充速度: 200mm/s 外壁速度: 80mm/s 内壁速度: 80mm/s 起始层速度: 50mm/s Skirt速度: 50mm/s	软件默认参数	软件默认参数	流量: 100%	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	需要封箱打印
拓竹	PIP		喷嘴温度:260℃ 底板温度:100℃ (PEI板, 涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外端: 150mm/s 内端: 200mm/s 稀疏填充: 200mm/s 内部实心填充: 200mm/s 顶面: 150mm/s 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 200mm/s 空驶速度: 200mm/s	首层: 500 外端: 5000 顶面: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	流量比例: 0.98	风扇: 关	22mm ³ /s	默认或根据需求调整	1.需要封箱打印2.同一个模型打印速度不要相差太大,速度相差太大,打印光泽度不一样。

ABS+	Bambu Lab	X1	喷嘴温度:260℃ 底板温度:100℃ (工程, 涂胶)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外墙: 150mm/s 内墙: 200mm/s 稀疏填充: 200mm/s 内部实心填充: 200mm/s 顶部: 150mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 200mm/s 空驶速度: 200mm/s	首层: 500 外墙: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	流量比例: 0.98	风扇: 关	22mm³/s	默认或根据需求调整	1.需要封箱打印2.同一个模型打印速度不要相差太大,速度相差太大,打印光泽度不一样。
	创想 Creality	Ender-3	喷嘴温度:240℃ 底板温度:100℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	打印速度: 50mm/s 填充速度: 50mm/s 速度(壁): 30mm/s 速度(外壁): 25mm/s 速度(内壁): 30mm/s 速度(顶部): 25mm/s 空驶速度: 100mm/s 起始层速度: 20mm/s Skirt速度: 20mm/s 较慢层数量: 2	关闭	层变化回抽: 开 回抽距离: 6mm 回抽速度: 40mm/s 装填速度: 40mm/s	流量: 100%	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	需要封箱打印
	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:255℃ 底板温度:100℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 起 线宽: 0.4mm 始层线宽: 130%	默认打印速度: 60mm/s 内墙打印速度: 30mm/s 外墙打印速度: 20mm/s 底层打印速度: 20mm/s 填充速度: 60mm/s 实心填充速度: 60mm/s X/Y轴运动速度: 100mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 60mm/s 薄壁结构速度: 40mm/s 填充空腔速度: 40mm/s 桥结构速度: 30mm/s 悬垂结构速度: 30mm/s	软件默认参数	软件默认速度	材料流量: 100%	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	需要封箱打印
	Prusa	MK3S+	喷嘴温度:250℃ 底板温度:100℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 50mm/s 小边界: 25mm/s 外轮廓: 25mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 150mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撞高Z: 0.2 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量: 50%	流量: 100%	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	需要封箱打印
	Voron	R2	喷嘴温度:255℃ 底板温度:100℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 80mm/s 小边界: 60mm/s 外轮廓: 80mm/s 填充: 150mm/s 实心填充: 150mm/s 顶部实心填充: 80mm/s 支撑材料: 150mm/s 桥接处: 40mm/s 间隙填充: 40mm/s 空驶速度: 200mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撞高Z: 0.2 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量: 0%	挤出倍数: 1	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	需要封箱打印
	安克	M5	喷嘴温度:250℃ 底板温度:100℃ (P涂胶)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	空驶速度: 250mm/s 打印速度: 200mm/s 填充速度: 200mm/s 外墙速度: 80mm/s 内墙速度: 80mm/s 起始层速度: 50mm/s Skirt速度: 50mm/s	软件默认参数	软件默认参数	风扇: 开 风扇速度: 100%	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	需要封箱打印
eTPU-95A	拓竹 Bambu Lab	PIP	喷嘴温度:220℃ 底板温度:45℃ (PET板)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外墙: 80mm/s 内墙: 150mm/s 稀疏填充: 150mm/s 内部实心填充: 150mm/s 顶部: 150mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外墙: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	回抽距离: 1.5mm 回抽速度: 30mm/s	流量比例: 1.05	风扇: 开 软件默认参数	5mm³/s	默认或根据需求调整	材料设置里面的回抽长度需要关闭。
		X1	喷嘴温度:220℃ 底板温度:30℃ (低温板, 需固体胶)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外墙: 80mm/s 内墙: 150mm/s 稀疏填充: 150mm/s 内部实心填充: 150mm/s 顶部: 150mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填充: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外墙: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	回抽距离: 1.5mm 回抽速度: 30mm/s	流量比例: 1.05	风扇: 开 软件默认参数	5mm³/s	默认或根据需求调整	材料设置里面的回抽长度需要关闭。
	创想 Creality	Ender-3	喷嘴温度:220℃ 底板温度:45℃	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	打印速度: 40mm/s 填充速度: 40mm/s 速度(壁): 15mm/s 速度(外壁): 15mm/s 速度(内壁): 15mm/s 速度(顶部): 20mm/s 空驶速度: 100mm/s 起始层速度: 15mm/s Skirt速度: 15mm/s 较慢层数量: 2	关闭	层变化回抽: 开 回抽距离: 2mm 回抽速度: 30mm/s 装填速度: 30mm/s	流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/	默认或根据需求调整	/
	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:225℃ 底板温度:45℃	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 起 线宽: 0.4mm 始层线宽: 130%	默认打印速度: 60mm/s 内墙打印速度: 30mm/s 外墙打印速度: 20mm/s 底层打印速度: 20mm/s 填充速度: 60mm/s 实心填充速度: 60mm/s X/Y轴运动速度: 100mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 60mm/s 薄壁结构速度: 40mm/s 填充空腔速度: 40mm/s 桥结构速度: 30mm/s 悬垂结构速度: 30mm/s	软件默认参数	软件默认参数	材料流量: 100%	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	/

	Prusa	MK3S+	喷嘴温度:225℃ 底板温度:60℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度:软件默认参数	轮廓: 50mm/s 小边界: 25mm/s 外圈轮廓: 25mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 80mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s	软件默认参数	回抽长度: 1mm 撤高低: 0.2 回抽速度: 30mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:0%	挤出倍数: 1.05	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
	Voron	R2	喷嘴温度:220℃ 底板温度:45℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度:软件默认参数	轮廓: 50mm/s 小边界: 40mm/s 外圈轮廓: 40mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 60mm/s 顶部实心填充: 60mm/s 支撑材料: 80mm/s 桥接处: 20mm/s 间隙填充: 20mm/s 空驶速度: 200mm/s	软件默认参数	回抽长度: 1mm 撤高低: 0.2 回抽速度: 25mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:0%	挤出倍数: 1.05	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
	安克	M5	喷嘴温度:225℃ 底板温度:60℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:默认参数	空驶速度: 250mm/s 打印速度: 100mm/s 填充速度: 100mm/s 外壁速度: 50mm/s 内壁速度: 50mm/s 起始层速度: 50mm/s Skirt速度: 50mm/s	软件默认参数	软件默认参数	挤出量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/	默认或根据需求调整	/
拓竹 Bambu Lab	PIP		喷嘴温度:220℃ 底板温度:45℃ (PET板)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外圈: 100mm/s 内圈: 150mm/s 稀疏填充: 150mm/s 内部实心填充: 150mm/s 顶部: 150mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填缝: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外圈: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	回抽距离: 1.5mm 回抽速度: 30mm/s	流量比例: 1.05	风扇: 开 软件默认参数	5mm ³ /s	默认或根据需求调整	材料设置里面的回抽长度需要关闭。
	X1		喷嘴温度:220℃ 底板温度:30℃ (低温板,需固体胶)	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外圈: 100mm/s 内圈: 150mm/s 稀疏填充: 150mm/s 内部实心填充: 150mm/s 顶部: 150mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填缝: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外圈: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	回抽距离: 1.5mm 回抽速度: 30mm/s	流量比例: 1.05	风扇: 开 软件默认参数	5mm ³ /s	默认或根据需求调整	材料设置里面的回抽长度需要关闭。
	创想 Creality	Ender-3	喷嘴温度:220℃ 底板温度:60℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:软件默认参数	打印速度: 40mm/s 填充速度: 40mm/s 速度(壁): 15mm/s 速度(外壁): 15mm/s 速度(内壁): 15mm/s 速度(顶部): 20mm/s 空驶速度: 100mm/s 起始层速度: 15mm/s Skirt速度: 15mm/s 较慢层数量: 2	关闭	层变化回抽: 开 回抽距离: 2mm 回抽速度: 30mm/s 装填速度: 30mm/s	流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/	默认或根据需求调整	/
eTPU-HS	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:225℃ 底板温度:60℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:0.4mm 起始层线宽:130%	默认打印速度: 60mm/s 内壁打印速度: 30mm/s 外壁打印速度: 20mm/s 底层打印速度: 20mm/s 填充速度: 60mm/s 实心填充速度: 60mm/s K/J轴运动速度: 100mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 60mm/s 薄壁结构速度: 40mm/s 填充空隙速度: 40mm/s 桥接速度: 30mm/s 悬垂结构速度: 30mm/s	软件默认参数	软件默认参数	材料流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/	默认或根据需求调整	/
	Prusa	MK3S+	喷嘴温度:220℃ 底板温度:60℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度:软件默认参数	轮廓: 50mm/s 小边界: 25mm/s 外圈轮廓: 25mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 80mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s	软件默认参数	回抽长度: 1mm 撤高低: 0.2 回抽速度: 30mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:0%	挤出倍数: 1.05	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
	Voron	R2	喷嘴温度:220℃ 底板温度:45℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度:软件默认参数	轮廓: 50mm/s 小边界: 40mm/s 外圈轮廓: 40mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 60mm/s 顶部实心填充: 60mm/s 支撑材料: 80mm/s 桥接处: 20mm/s 间隙填充: 20mm/s 空驶速度: 200mm/s	软件默认参数	回抽长度: 1mm 撤高低: 0.2 回抽速度: 25mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:0%	挤出倍数: 1.05	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
	安克	M5	喷嘴温度:225℃ 底板温度:60℃	层高:0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽:默认参数	空驶速度: 250mm/s 打印速度: 100mm/s 填充速度: 100mm/s 外壁速度: 50mm/s 内壁速度: 50mm/s 起始层速度: 50mm/s Skirt速度: 50mm/s	软件默认参数	软件默认参数	挤出量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/	默认或根据需求调整	/

ePA-CF	拓竹 Bambu Lab	X1	喷嘴温度:280℃ 底板温度:100℃ (工程, 涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外墙: 150mm/s 内墙: 200mm/s 稀疏填充: 200mm/s 内部实心填充: 200mm/s 顶部: 150mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填缝: 200mm/s 空驶速度: 200mm/s	首层: 500 外墙: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	流量比例: 0.98	风扇: 关	10mm³/s	默认或根据需求调整	需要封箱打印
	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:280℃ 底板温度: 60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 0.4mm 始层线宽: 130%	默认打印速度: 60mm/s 内墙打印速度: 30mm/s 外墙打印速度: 20mm/s 底层打印速度: 20mm/s 填充速度: 60mm/s 实心填充速度: 60mm/s X/Y轴运动速度: 100mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 60mm/s 薄壁结构速度: 40mm/s 填充空隙速度: 40mm/s 桥接速度: 30mm/s 垂直结构速度: 30mm/s	关	软件默认参数	材料流量: 100%	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	需要恒温封箱打印。
	Prusa	MK3S+	喷嘴温度:275℃ 底板温度: 60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 40mm/s 小边界: 25mm/s 外围轮廓: 25mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 50mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撞高Z: 关 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回缩时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:50%	挤出倍数: 0.98	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	1. 需要恒温封箱打印 2. 容易磨损喷头, 需要更换硬化喷嘴。
	Voron	R2	喷嘴温度:280℃ 底板温度: 60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 60mm/s 小边界: 50mm/s 外围轮廓: 50mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 50mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撞高Z: 关 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回缩时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:50%	挤出倍数: 0.98	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	1. 需要恒温封箱打印 2. 容易磨损喷头, 需要更换硬化喷嘴。
ePA12-CF	拓竹 Bambu Lab	X1	喷嘴温度:280℃ 底板温度: 100℃ (工程, 涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外墙: 150mm/s 内墙: 200mm/s 稀疏填充: 200mm/s 内部实心填充: 200mm/s 顶部: 150mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填缝: 200mm/s 空驶速度: 200mm/s	首层: 500 外墙: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	流量比例: 0.98	风扇: 关	10mm³/s	默认或根据需求调整	需要封箱打印
	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:280℃ 底板温度: 60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 0.4mm 始层线宽: 130%	默认打印速度: 60mm/s 内墙打印速度: 30mm/s 外墙打印速度: 20mm/s 底层打印速度: 20mm/s 填充速度: 60mm/s X/Y轴运动速度: 100mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 60mm/s 薄壁结构速度: 40mm/s 填充空隙速度: 40mm/s 桥接速度: 30mm/s 垂直结构速度: 30mm/s	软件默认参数	软件默认参数	材料流量: 100%	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	需要封箱打印
	Prusa	MK3S+	喷嘴温度:275℃ 底板温度: 60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 40mm/s 小边界: 25mm/s 外围轮廓: 25mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 50mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撞高Z: 关 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回缩时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:50%	挤出倍数: 0.98	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	1. 需要恒温封箱打印 2. 容易磨损喷头, 需要更换硬化喷嘴。
	Voron	R2	喷嘴温度:280℃ 底板温度: 60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 60mm/s 小边界: 50mm/s 外围轮廓: 50mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 50mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 撞高Z: 关 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回缩时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:50%	挤出倍数: 0.98	风扇: 关	/	默认或根据需求调整	1. 需要恒温封箱打印 2. 容易磨损喷头, 需要更换硬化喷嘴。
拓竹 Bambu Lab	PIP	喷嘴温度:220℃ 底板温度: 60℃ (PET板)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外墙: 200mm/s 内墙: 300mm/s 稀疏填充: 300mm/s 内部实心填充: 250mm/s 顶部: 200mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填缝: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外墙: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	软件默认参数	流量比例: 1.0	风扇: 开 软件默认参数	22mm³/s	默认或根据需求调整	/
	X1	喷嘴温度:220℃ 底板温度: 35℃ (低温板, 涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外墙: 200mm/s 内墙: 300mm/s 稀疏填充: 300mm/s 内部实心填充: 250mm/s 顶部: 200mm/s 悬垂降速: 开 悬垂速度: 默认 桥接: 50mm/s 填缝: 250mm/s 空驶速度: 300mm/s	首层: 500 外墙: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	软件默认参数	软件默认参数	流量比例: 1.0	风扇: 开 软件默认参数	22mm³/s	默认或根据需求调整	/

ePLA-Metal	创想 Creality	Ender-3	喷嘴温度:215℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	打印速度: 50mm/s 填充速度: 50mm/s 速度(壁): 30mm/s 速度(外壁): 25mm/s 速度(内壁): 30mm/s 速度(顶部): 25mm/s 空驶速度: 100mm/s 起始层速度: 20mm/s Skirt速度: 20mm/s 较慢层数量: 2	关闭	层变化回抽: 开 回抽距离: 6mm 回抽速度: 40mm/s 装填速度: 40mm/s	流量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/	默认或根据需求调整	/
	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:225℃ 底板温度:60℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 起 线宽: 0.4mm 始层线宽: 130%	默认打印速度: 60mm/s 内层打印速度: 30mm/s 外壁打印速度: 20mm/s 底层打印速度: 20mm/s 填充速度: 60mm/s 实心填充速度: 60mm/s X/Y轴运动速度: 100mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 60mm/s 薄壁结构速度: 40mm/s 填充空隙速度: 40mm/s 桥结构速度: 30mm/s 悬垂结构速度: 30mm/s	软件默认参数	软件默认速度	材料流量: 95%	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
	Prusa	MK3S+	喷嘴温度:215℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 50mm/s 小边剪: 25mm/s 外围轮廓: 25mm/s 填充: 80mm/s 实心填充: 80mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 50mm/s 桥接处: 25mm/s 间隙填充: 40mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:0%	挤出倍数: 1	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
	Voron	R2	喷嘴温度:225℃ 底板温度:60℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 150mm/s 小边剪: 80mm/s 外围轮廓: 80mm/s 填充: 150mm/s 实心填充: 150mm/s 顶部实心填充: 80mm/s 支撑材料: 150mm/s 桥接处: 40mm/s 间隙填充: 40mm/s 空驶速度: 200mm/s	软件默认参数	回抽长度: 2mm 回抽速度: 40mm/s 层变化回抽: 开 回抽时擦拭: 开 擦拭前的回缩量:0%	挤出倍数: 1.02	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
	安克	M5	喷嘴温度:215℃ 底板温度:60℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	空驶速度: 250mm/s 打印速度: 150mm/s 填充速度: 150mm/s 外壁速度: 50mm/s 内壁速度: 50mm/s 起始层速度: 50mm/s Skirt速度: 50mm/s	软件默认参数	软件默认参数	挤出量: 100%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/	默认或根据需求调整	/
ePLA-LW	拓竹 Bambu Lab	PIP	喷嘴温度:250℃ 底板温度:45℃ (PEI板)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外端: 100mm/s 内端: 100mm/s 稀疏填充: 100mm/s 内部实心填充: 100mm/s 顶部: 100mm/s 悬垂降速: 关 悬垂速度: 默认 桥接: 100mm/s 填充: 100mm/s 空驶速度: 100mm/s	首层: 500 外端: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	回抽: 关	流量比例: 0.5	风扇: 开 软件默认参数	20mm ³ /s	默认或根据需求调整	/
		X1	喷嘴温度:250℃ 底板温度:45℃ (低温板, 涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 默认参数	首层速度: 50mm/s 首层填充: 50mm/s 外端: 100mm/s 内端: 100mm/s 稀疏填充: 100mm/s 内部实心填充: 100mm/s 顶部: 100mm/s 悬垂降速: 关 悬垂速度: 默认 桥接: 100mm/s 填充: 100mm/s 空驶速度: 100mm/s	首层: 500 外端: 5000 顶部: 2000 普通打印: 10000	回抽: 关	流量比例: 0.5	风扇: 开 软件默认参数	20mm ³ /s	默认或根据需求调整	/
	创想 Creality	Ender-3	喷嘴温度:240℃ 底板温度:50℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 线宽: 软件默认参数	打印速度: 40mm/s 填充速度: 40mm/s 速度(壁): 40mm/s 速度(外壁): 40mm/s 速度(内壁): 40mm/s 速度(顶部): 40mm/s 空驶速度: 40mm/s 起始层速度: 40mm/s Skirt速度: 40mm/s 较慢层数量: 2	关闭	回抽: 关	流量: 55%	风扇: 开 风扇速度: 100%	/	默认或根据需求调整	/
	复志 Raise3D	Pro3 Plus	喷嘴温度:240℃ 底板温度:50℃	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 起 线宽: 0.4mm 始层线宽: 130%	默认打印速度: 40mm/s 内层打印速度: 40mm/s 外壁打印速度: 40mm/s 底层打印速度: 40mm/s 填充速度: 40mm/s 实心填充速度: 40mm/s X/Y轴运动速度: 40mm/s Z轴运动速度: 15mm/s 支撑打印速度: 40mm/s	关闭	回抽: 关	材料流量: 55%	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
Prusa	MK3S+	喷嘴温度:240℃ 底板温度:45℃ (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm(0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 40mm/s 小边剪: 40mm/s 外围轮廓: 40mm/s 填充: 40mm/s 实心填充: 40mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 40mm/s 桥接处: 40mm/s 间隙填充: 40mm/s	关闭	回抽: 关	挤出倍数: 0.55	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/	

Voron	R2	喷嘴温度: 240°C 底板温度: 45°C (涂胶)	层高: 0.1-0.2mm (0.4mm喷嘴) 挤出宽度: 软件默认参数	轮廓: 40mm/s 小边界: 40mm/s 外圈轮廓: 40mm/s 填充: 40mm/s 实心填充: 40mm/s 顶部实心填充: 40mm/s 支撑材料: 40mm/s 桥接处: 40mm/s 间隙填充: 40mm/s	关闭	回抽: 关	挤出倍数: 0.55	风扇: 开 软件默认参数	/	默认或根据需求调整	/
-------	----	-----------------------------------	---	--	----	-------	------------	-----------------	---	-----------	---

***以上数据来源于eSUN产品中心测试，测试环境温度均在18-28℃；不同环境温度下，打印参数也会有一些不同。请注意，当打印速度相差较大时，模型表面会呈现不同的光泽度，请尽量将模型表面打印速度设置一致。Bambu Lab打印机打印TPU时将材料设置里面的回抽长度关闭。**